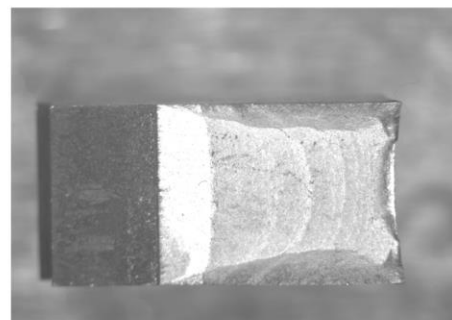
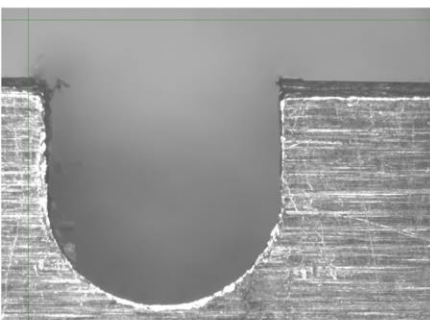
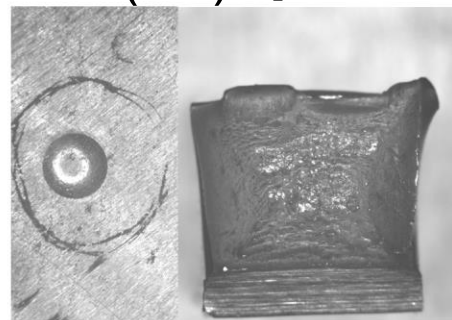
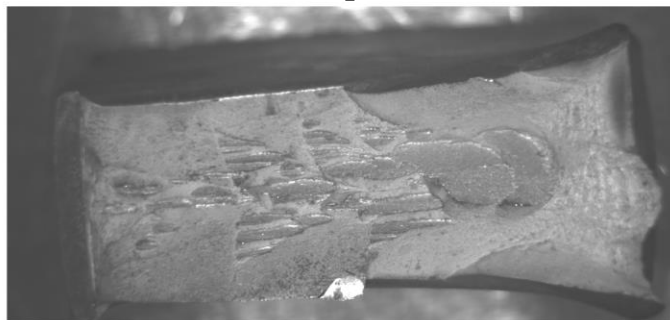
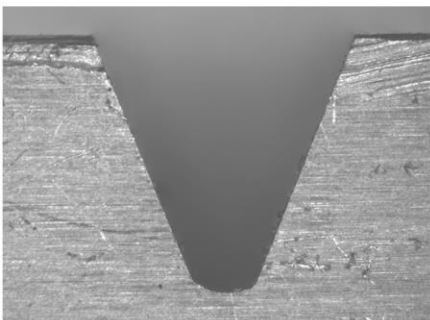


[综合测量分析仪 (II)]



www.xa-surmount.com.cn

COMPANY

西安思迈机电科技有限公司

Xi 'an, mechanical and electrical technology co., LTD

[产品方案书]

Product Plan Book

TOP-IG TOP-FE TOP-BV TOP-COMPLEX I TOP-COMPLEX II TOP-IG TOP-FE TOP-BV TOP-COMPLEX I

TOP-COMPLEX II TOP-IG TOP-FE TOP-BV TOP-COMPLEX I TOP-COMPLEX II TOP-IG TOP-FE TOP-BV

TOP-COMPLEX I TOP-COMPLEX II TOP-IG TOP-FE TOP-BV TOP-COMPLEX I

TOP-FE TOP-BV TOP-COMPLEX I TOP-COMPLEX II TOP-IG TOP-FE TOP-BV TOP-COMPLEX I TOP-COMPLEX

II TOP-IG TOP-FE TOP-BV TOP-COMPLEX I

TOP-COMPLEX II TOP-IG TOP-FE TOP-BV TOP-COMPLEX I TOP-COMPLEX II TOP-IG TOP-FE TOP-BV

目 录

目 录.....	2
设备说明	3
产品阐述	3
设备组成	3
结构与性能.....	4
主机:	4
光源:	4
载物台:	4
数字光学采集:	4
专用软件	4
试样缺口	5
试样断口	6
膨胀值	6
WDTT.....	7
Kic 裂纹.....	7
W (AO)	8
硬度压痕	8
技术参数	8
执行标准	9

设备说明

名称：综合测量分析仪

型号：TOP- Complex II

生产商：西安思迈机电科技有限公司

用途：

该产品适用于对金属材料落锤（DWTT）、摆锤冲击、拉伸试样断口、缺口、膨胀值、裂纹长度、布氏硬度、维氏硬度、CTOD 裂纹、K_{IC} 临界裂纹、线段、角度、圆心、矩形等测量分析工作。通过其特定的电子光学采样系统对冲击试样断口形貌进行全视野实时采样，可完成对落锤、摆锤冲击试样断口纤维率进行测量。操作方便，准确率高，并能进行以往手工不能完成的操作。储存的结果数据可供用户进行反复核对处理。

该机适用于测量金属材料在动负荷下抵抗冲击性能的配套检测仪器，是金属材料生产厂家，产品质量检验，大专院校及科研单位进行新材料研究不可缺少的测试仪器。

产品阐述

随着国内工业技术的发展，越来越多的行业已经开始执行 GB/T229-2007《金属夏比冲击试验方法》GB/T5482-2007（金属材料动态撕裂试验方法）、GB/T 8363-2007（铁素体钢落锤撕裂试验方法）、ASTM E23 及相关的 ISO 标准，所以在整个试验后，通过冲击试样断口分析材料至关重要。帮助实验人员更真实的了解材料的特性，分析实验数据的准确性等，其质量检验是一个重要的控制手段，目前，我公司通过电子光学投影技术检验实现了切实可行的方法。

OP-Complex II 综合测量分析仪是我公司根据广大用户的实际需要和 GB/T299-2007《金属夏比冲击试验方法》GB/T5482-2007（金属材料动态撕裂试验方法）、GB/T 8363-2007（铁素体钢落锤撕裂试验方法）中对冲击试样断口的要求而开发的一种专用于检验冲击试样断口精密测量的精密仪器。该仪器是利用光学投影方法将被测的冲击试样断口全貌显示在 PC 上，让试验人员更清楚的观看、测量、分析冲击试样断口的形貌，来分析材料特性以及试验数据。其优点是操作简便，对比直观，消除了人员测量的操作误差，解决了常规无法测量的问题，保存数据为以备日后复查提供可靠地数据。

设备组成

系统名称	类别	配置要求
A、主机	包括机架、调节系统、	必配
B、光源	高亮度、低功耗 LED	必配
C、载物台	X、Y 可调 70*50	必配
D、数字光学采集	CMOS，镜头及连接装置 USB 连接线	必配
E、分析软件	SMTMeasSystem_Complex II 测量软件包	必配

F、PC	21 寸显示器 1600*900 以上分辨率、CPU 主频 3.2GHz 以上、独立显卡。	用户自备
G、标定尺	专用标尺	必须
H、授权加密狗	USB 授权加密	必须
I、试样专用夹具	手动加、专用于落锤试样等大试样	必须
J、专用夹具		必须

结构与性能

主机：

采用高精度滚轴丝杠及研究级线性滑组。

工业铝型材外壳，美观、高刚性。

步进电机调整 Z 轴空间，平稳、准确。

光源：

亮度高、功耗低、发热少、寿命长，发光均匀，为采集系统提供了良好的光环境。

载物台：

调节试样、快速，每次试样都可以快速的调节合适的位置上，消除了人为调节试样的麻烦。

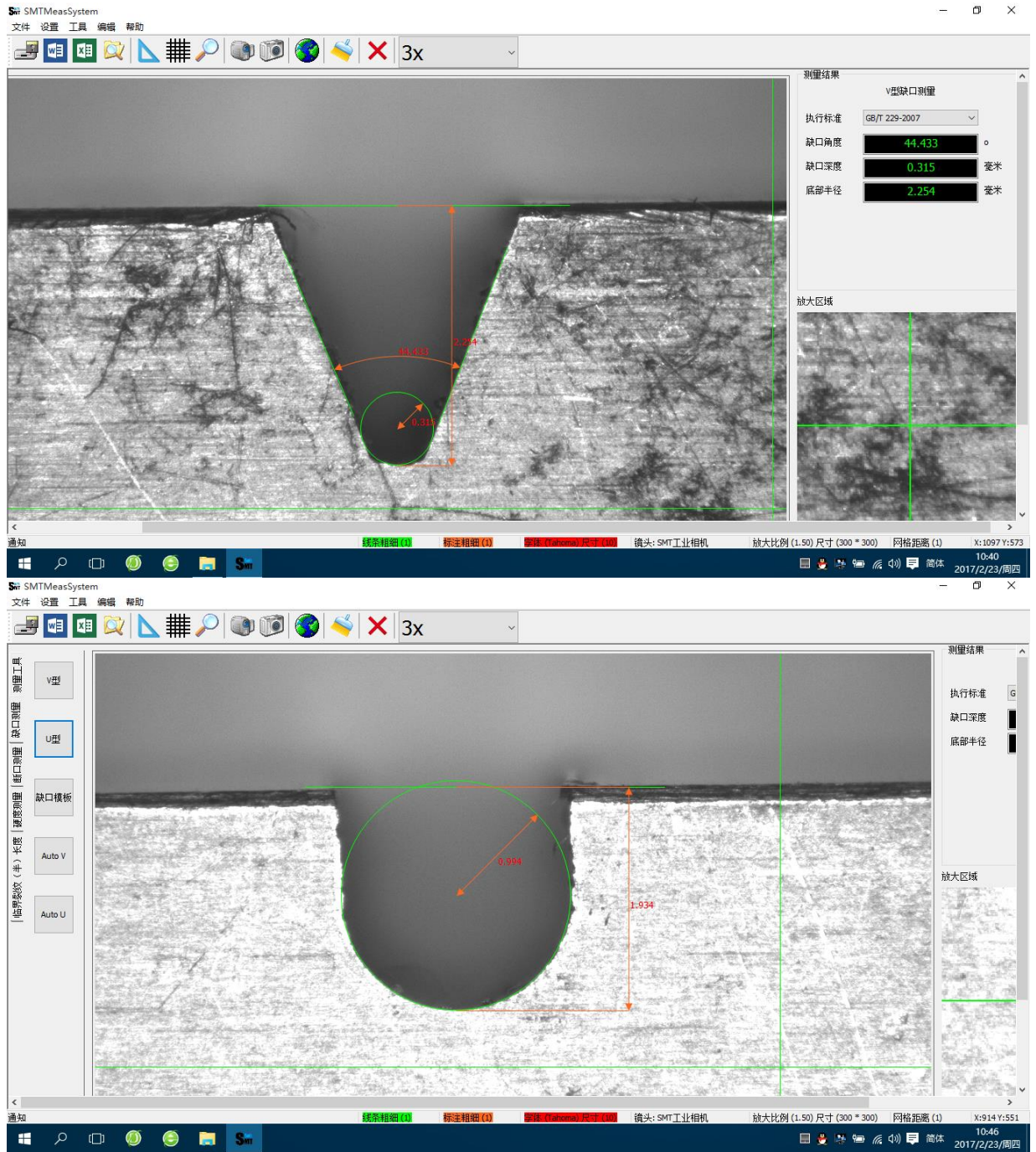
数字光学采集：

500 像素高精度工业级镜头以及高质量工业级 CMOS 保证了成像的高清晰，SMT 专用镜头，快速光学数字采集卡提供了快速采集数据的平台，使试样结果分析时间大大减少。

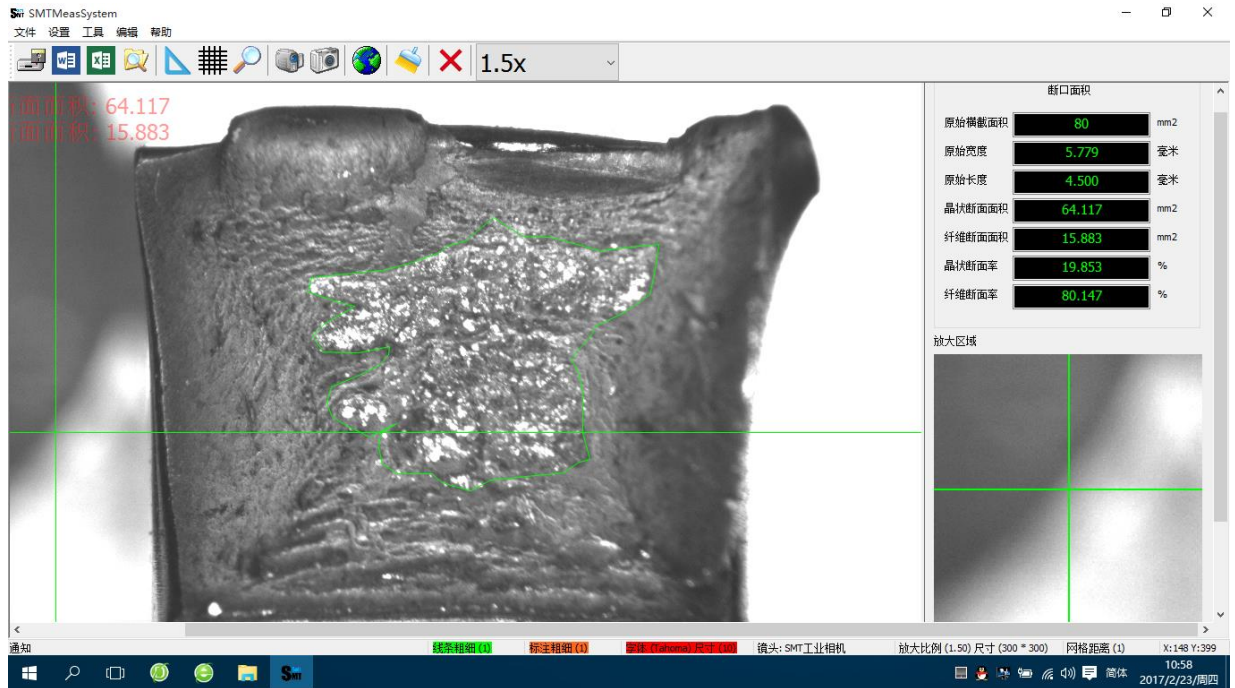
专用软件

SMTMeasSystem_Complex_II_4.0 综合测量影像系统，主要用于试样尺寸、断口、缺口、Kic、W (AO)、硬度压痕测量；

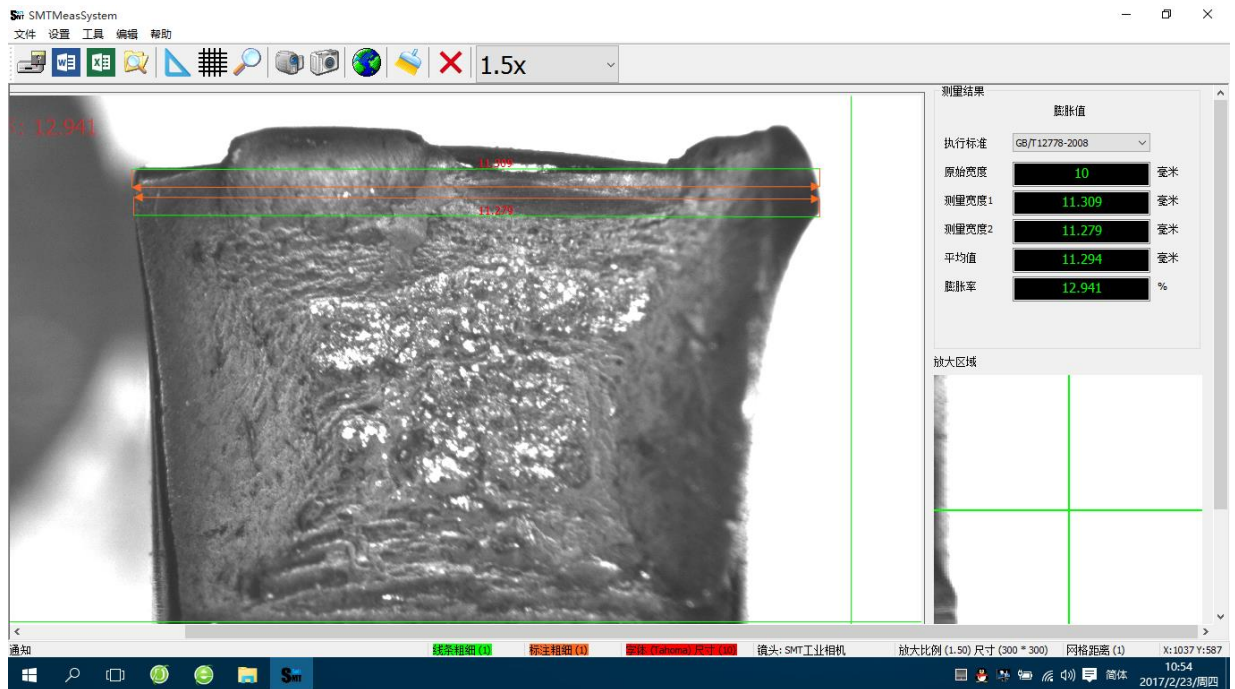
试样缺口



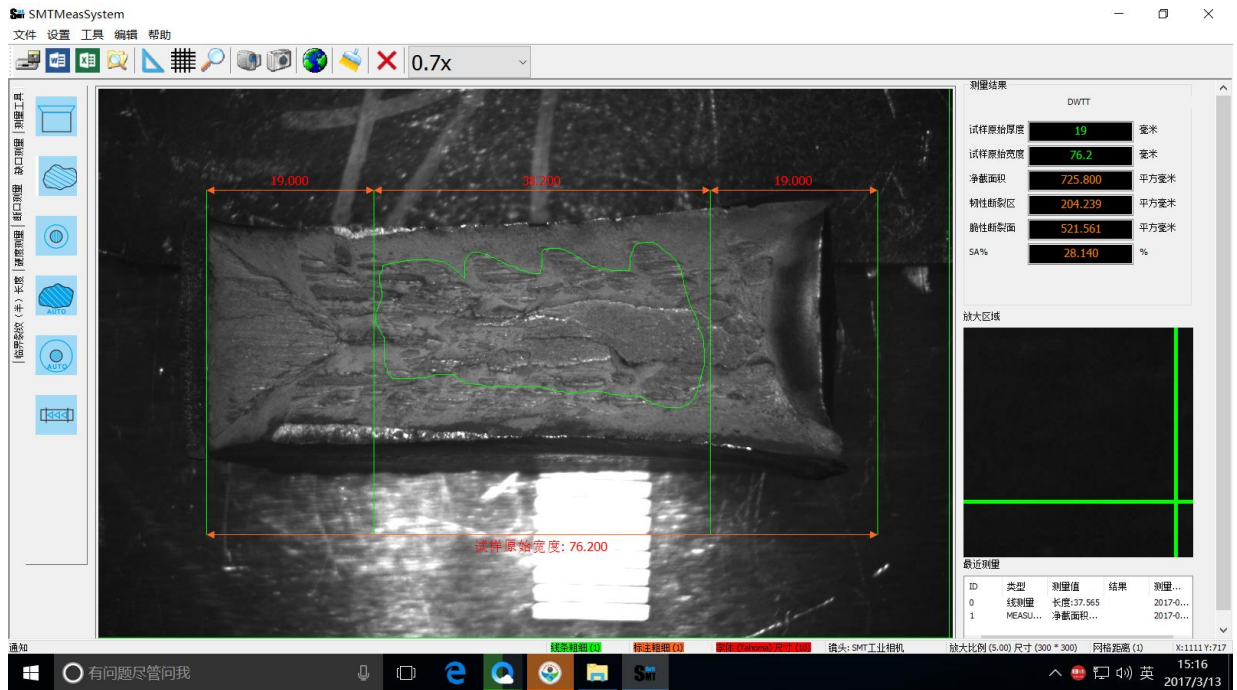
试样断口



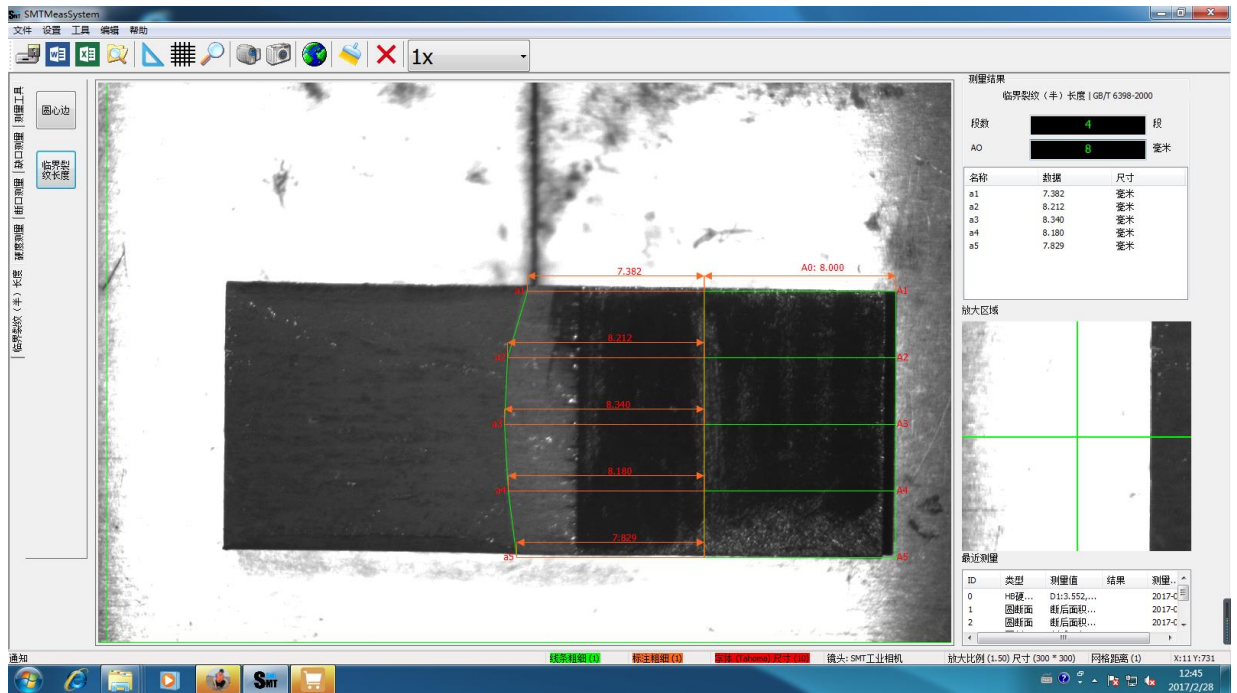
膨胀值



DWTT



Kic 裂纹



W (AO)



硬度压痕



技术参数

CCD 图像摄像头：图像传感器为不小于 1/2 英寸，像素数为 500 万。

操作系统：windows7、windows8、windows10 等。

测量精度 0.001mm

分辨率：2592 x 1944

结果 WORD、EXCEL 格式导出；

计算机自动计算试样分析结果，可打印试验报告。

外型尺寸： 300mm×400mm×1200mm（长×宽×高）

总功率：5W

电源：5V USB 供电

环境条件：周围环境无腐蚀介质，无震动，无强电磁场干扰

执行标准

GB/T 229-2007《金属夏比冲击试验方法》

GB/T12778-2008《金属夏比冲击断口测定方法》

GB/T5482-2007（金属材料动态撕裂试验方法）

GB/T 8363-2007(铁素体钢落锤撕裂试验方法)

GB/T231-2002 《金属布氏硬度试验》

GB/T 4340.1-2009《金属维氏硬度试验》

GB/T 6398-2000《金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法》